

第8回LPBフォーラム

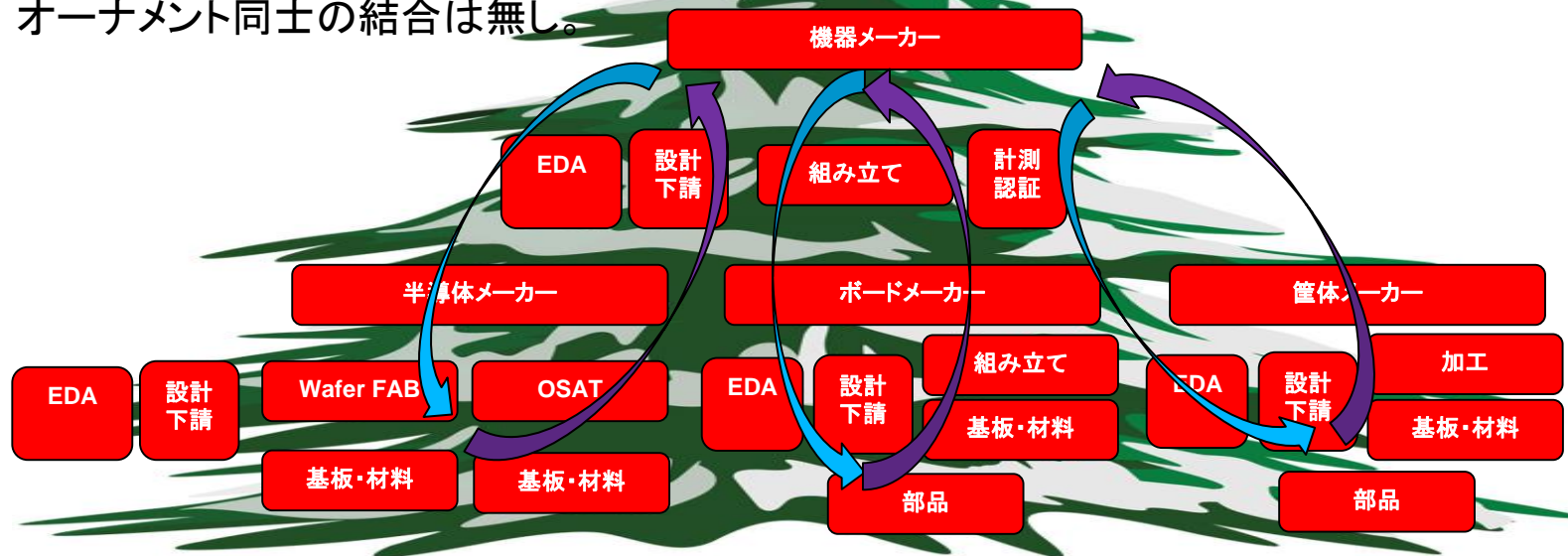
- 日時 平成28年3月11日(金) 14:00～17:00(13:30より受付)
 - 場所 (社)電子情報技術産業協会 大手センタービル
 - 1. 開会の挨拶
 - 2. LPBフォーマットの概要、採用状況
 - 3. IEEE/IEC国際標準化の状況
 - 4. LPBフォーマットのロードマップ
 - 5. ユーザによるLPB活用設計事例
 - a) LPBフォーマットを活用した設計環境/株式会社リコー
 - b) LPBによる垂直給電実装検討/富士通アドバンステクノロジー株式会社
 - c) GemPackageを活用したボードとLSIのEMC構想設計/株式会社デンソー
 - 6. EDAベンダーによるLPB応用事例
 - a) Cフォーマット対応によるコンデンサ最適化のTAT短縮/アンシス・ジャパン株式会社
 - b) スクリプトによるLPBシミュレーション効率化/メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社
 - c) LPBフォーマットによるチップ・パッケージプランニングとシミュレーション/日本ケイデンス・デザイン・システムズ社・株式会社ジェム・デザイン・テクノロジーズ
 - d) LPB入出力を活用した、3Dモジュール構想設計向けシステムの構築事例/株式会社ファースト
 - 7. 閉会の挨拶、連絡事項
- 懇親会 (17:30～)
- 資料は
- http://www.lpb-forum.com/lpb_forum8/lpb_forum8.html

1. 開会の挨拶

水平分業とよく言いますが...

仮想垂直統合のようなもの。

木にぶら下がる(元請した受けの弱い関係)オーナメント
オーナメント同士の結合は無し。



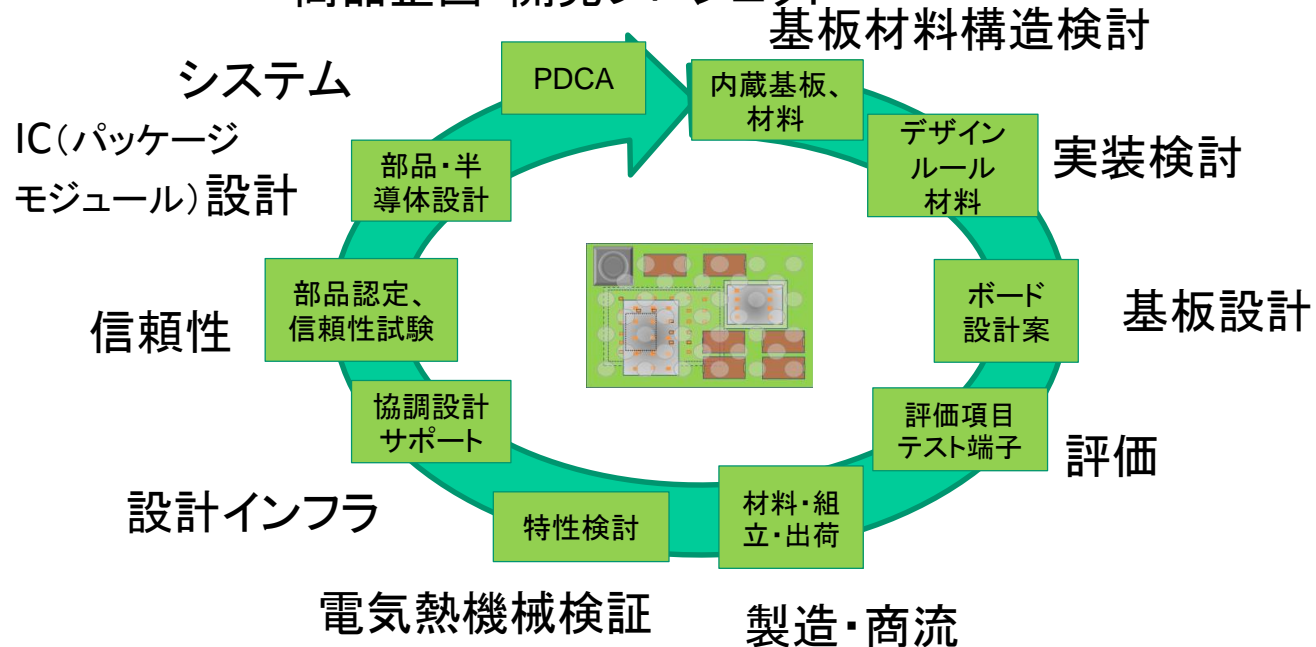
決してこれを悪いといっているわけではありません。

時間(人、金)をかければ、きっと良いものができるでしょう。

しかし、今の世の中、これで戦えるでしょうか？

グローバル分業体制下のプロジェクト

- 日本は本来プロジェクト管理は優秀＝差別化部分
商品企画・開発プロジェクト



- つなぎ部分か課題:**
 - 体制・情報・ノウハウがすべて社内にあったときは競争力を発揮。
 - グローバル分業では情報は外！情報形式の違いが障壁。差別化技術が発揮できない

バリューチェーンを機能させる情報交換が必要

バリューをつなぐもの

- 激烈な開発競争で許された時間とリソースの中で個々に存在するよい技術をタイムリーに採用するにはプラグインで試して見れる互換性、流通性が必要。
- これを実現するには三つの要素。
 1. 設計ターゲット: 構想設計力 (差別化部分)
 2. インターフェース: **IEEE2401** (共通化部分)
 3. モデル: 設計要素・素材の表現 (差別化部分、
但し、**書式は共通**)

本日はインターフェースの部分がテーマ

競争領域と非競争領域

課題のイメージ



競争領域



非競争領域

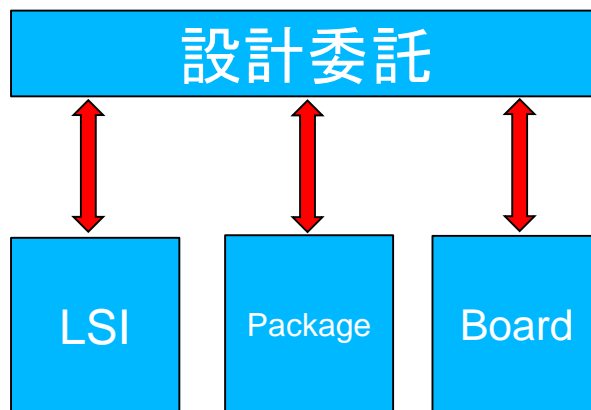


電話・E-mail・PDF・Excelファイル
⇒変換・手作業

すべて内側にある: 垂直統合

インターフェースが弱い水平分業

インターフェースを共通化し、グローバル仮想垂直統合を形成



日本の武器: 構想力・設計力・開発全体統率力
かって多くのイノベティブな商品が生み出された。
ウォークマン、DVD、カーナビ等

既存のもののチョコ変製品開発。
コストだけに陥った開発思想。
競争力ある製品は生まれない。

イノベーションを生む、設計力・体制が再生される。
競争領域部分で勝負できる。

非競争領域は国際標準にしてサプライチェーンに広げる

来期のJEITAの活動

インターフェースを共通化し、グローバル仮想垂直統合を形成

競争領域 非競争領域



イノベーションを生む、設計力・体制が再生される。
競争領域部分で勝負できる。

発足：

半導体設計技術小委員会
「半導体を使いこなす設計技術」

● 国際標準化・企画WG

● LPB相互設計SC

- LPBインターフェースWG
- LPBモデリングWG

非競争領域を精査し、発展・整理し、必要なものを国際標準に